
Company Introduction

디지털 강국 대한민국을 이끄는 꿈,
대한민국 장비 산업의 내일을 디자인합니다.

디지털 강국 대한민국을 이끄는 꿈
**대한민국 장비 산업의
내일을 디자인합니다**

회 사 명	(주)원익IPS
대 표 이 사	안태혁
설 립 일	1991.09.19
본 사 주 소	경기도 평택시 진위면 진위산단로 75
임 직 원 수	1,472명 (2025년 10월 31일 기준)
주 요 사 업	반도체 / 디스플레이 전 공정 핵심장비
자 본 금	245.4억 (총 발행 주식 49,083,901주)
상 장 일	1996년 9월 24일 (KOSDAQ)
홈 페이지	www.ips.co.kr

장비 국산화의 시작에 원익IPS가 있습니다

Global 종합 장비 기업으로 거듭나겠습니다

2021~

2022.06 진위3산단반도체 제조 센터 완공

2016~

2019.02 원익IPS & 테라세미콘 흡수 합병

2016.07 최대주주변경

: 前 원익 → 後 원익홀딩스

2016.05 KOSDAQ 증권시장 재상장

2016.04 회사인적 분할

(존속: 원익홀딩스 / 신설: 원익IPS)

2011~2015

2014.01 원익IPS 지분 13.15% 인수
(최대주주 등재)

2012.06 둔포캠퍼스 완공

2011.03 사명변경: 원익IPS

1999~2010

2010.12 원익 & 원익IPS 법인 합병

2006.11 특수가스 사업부문 물적 분할 :
원익머트리얼즈

2005.10 원익IPS 원익 인수

1999.01 원익IPS_원익 계열사 편입

공정 · 투명으로 창조적 기술과 서비스를 제공하여 인류발전에 공헌한다



자유

고정관념이나 관행을 벗어나 열린 사고를
통해 남다른 방안을 마련하고 책임감을
가지고 스스로 실행하는 것



소통

진실한 마음으로 상대의 입장을 이해하고
합리적 표현을 기반으로 서로의 경험과
지식, 정보를 공유함으로써 구성원들이
한 방향을 향해 가는 것



행복

구성원 모두가 '원익인'이라는 자부심을 갖고
신뢰를 기반으로 즐거운 일터를 만들며,
일을 통해 성취감과 보람을 느끼는 것

국내 5개 사업장, 4개 CS Site **해외** 5개 법인, 1개 지사, 1개 CS Site

진위사업장 (HQ)

반도체 Clean Room 및 R&D LAB
 - 개발 Class 10 수준
 - 부품개발 Lab실 운영
 반도체 영업 / STAFF

기흥사업장

반도체 Thin film 개발
 Software / STAFF

이천 사업장

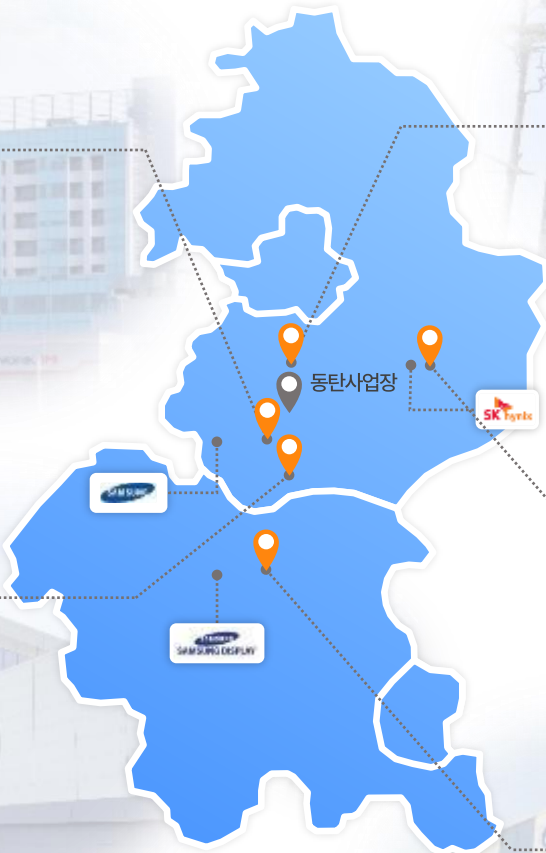
반도체 SKH 영업 / CS 센터

둔포사업장

Display 사업본부
 Display 제조 센터
 - Capacity 80 Chamber / 월

진위 3산단

반도체 통합 제조 센터 (T/F, Diffusion)
 Training Center 운영
 Capacity : 반도체 T/F 85 System / 월
 반도체 Diff. 26 System / 월



CS Site 평택 / 화성 / 청주 / 천안

해외거점

미 국	텍사스 / 뉴욕(site)
중 국	서안 / 우시 / 쿤산
싱가폴	우드랜드
대 만	신죽 (지사)

반도체 · LCD · AMOLED 핵심 장비를 보유하고 있으며,
지속적인 R&D를 통한 사업다각화로 세계속의 종합장비기업으로 성장하고 있습니다.

WONIK IPS Business Portfolio

Semiconductor

Deposition

GEMINI™ (CVD/ALD)

NOA™ (CVD/ALD)

HyEta™ (ALD)

CUARTO VS™ (CVD)

LEVATA-CP™ (CVD)

CLARO™ (ALD)

PRESTO™ (ALD)

VELOCE™ (ALD)

Thermal System

300SERIES™

MODUS™

Display

Deposition

BP PECVD

TFE PECVD

Etching

ICP Dry Etcher

CCP Dry Etcher

Laser Etcher

Laser Driller

Thermal System

PI Cure

LT/IGZO Furnace

GEMINI™

적용공정 : DRAM / NAND / Logic
 Dielectric CVD / ALD
 Process : SiON / a-Si / SiO₂ (@TEOS, SiH₄)
 ALD OX / SiN / SiOC / SiCN

핵심 기술력

1. High Temp. Extreme stability
2. Wafer centering technology
3. Auto level system

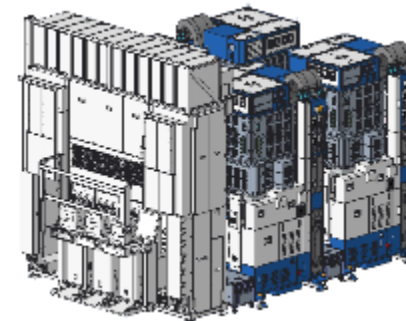


CUARTO VS™

적용공정 : NAND
 Dielectric CVD
 Process : ON-Stack, High Thick TEOS,
 Seem free Oxide

핵심 기술력

1. High Throughput, compact layout
2. Minimize dead volume, mini block
3. ESC & IMS
4. Extreme stress control



NOA™

적용공정 : DRAM / NAND
 Dielectric CVD, ALD
 Process : Ti / TiN / W

핵심 기술력

1. Large capacity, flow rate system
2. Horizontal monitoring system (Stage heater)



HyEta™

적용공정 : DRAM / NAND
 Dielectric ALD
 Process : SiO₂ Seamless Gap Fill / ZrO₂ / AlO

핵심 기술력

1. Gas balance control technology
2. Dual pumping structure



300SERIES™

적용공정 : DRAM / NAND

Dielectric CVD

Process : Oxidation / Anneal / Alloy / PI bake Poly / ALD Ox/SiN



핵심 기술력

1. High productivity, small footprint
2. Advanced heater temp. control

LEVATA-CP™

적용공정 : DRAM / NAND

Dielectric CVD

Process : Poly



핵심 기술력

1. High productivity, small footprint
2. Excellent thickness uniformity
3. Complete load lock control

Dry Etcher

ICP Type Antenna
Process : OLED / a-Si / Oxide

핵심 기술력

1. High etch rate & throughput
2. Long term PM cycle
3. Easy maintenance

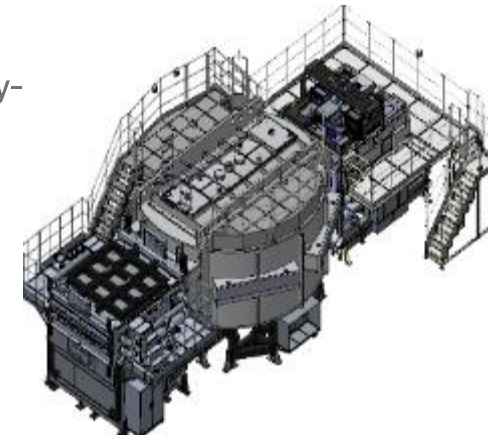


BP PECVD

High Temp. Process
Process : SiNx / SiOx / a-Si / Poly-

핵심 기술력

1. Low damage plasma mode
2. High quality film uniformity
3. Muti zone & Bias susceptor



Dry Etcher

CCP Type
Process : LCD & OLED / a-Si / Oxide

핵심 기술력

1. High etch rate & throughput
2. Unique arc management
3. Advanced particle management

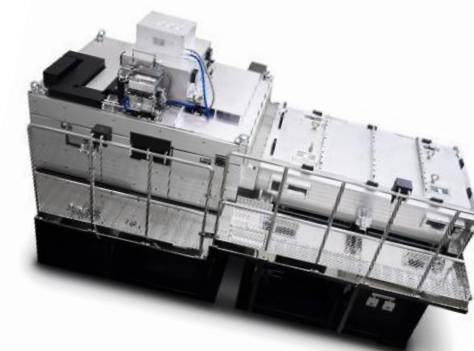


TFE PECVD

Low Temp. Process
Process : SiON / SiNx / SiO2

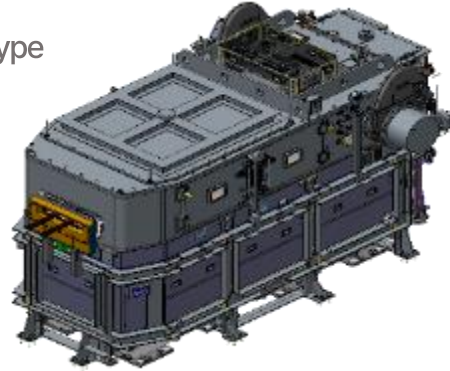
핵심 기술력

1. Low damage plasma mode
2. High quality film uniformity
3. Controllable film stress



Laser Etcher

Bottom-Up / Top-Down process type
Process : EV In-line etch by laser



핵심 기술력

1. High precision hole etch
2. High precision moving stage
3. High vacuum process

PI Cure

Flexible OLED TFT Backplane
Process : PI Film Cure

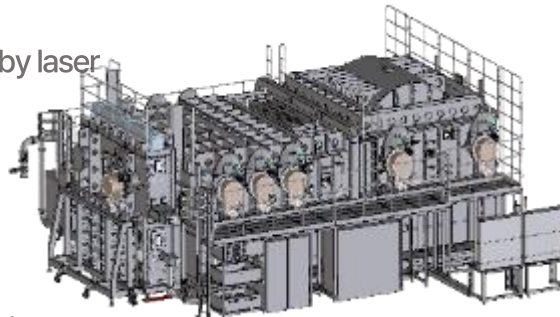


핵심 기술력

1. Fast ramping process
2. Uniform laminar flow control
3. Structure for particle suppression

Laser Driller

Bottom-Up process type
Process : EV In-line drilling by laser



핵심 기술력

1. High precision Drilling
2. Flip & High precision moving stage
3. High vacuum process

LT Furnace

Rigid & Flexible Backplane
Process : Contact Anneal, Activation

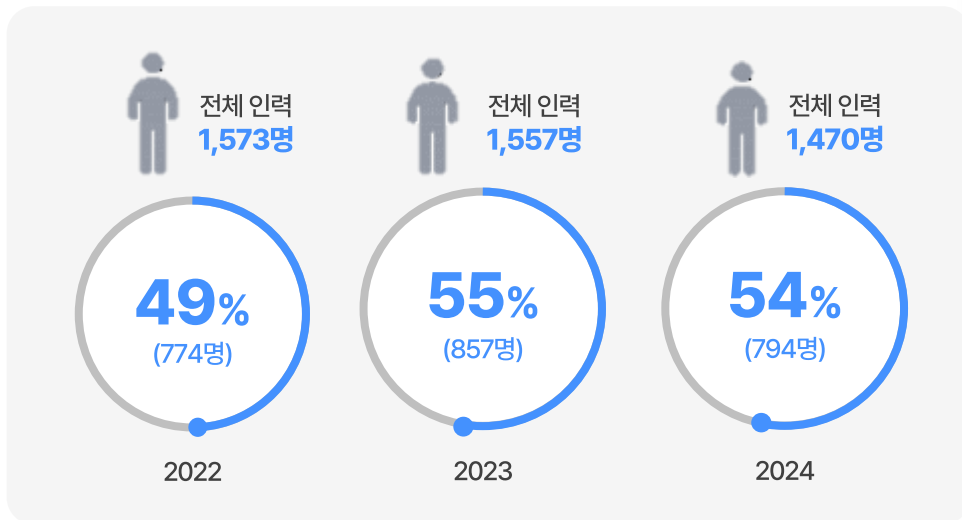


핵심 기술력

1. Excellent temp. uniformity
2. High productivity (Fast ramp up/down)
3. Perfect sealing for O2 density control

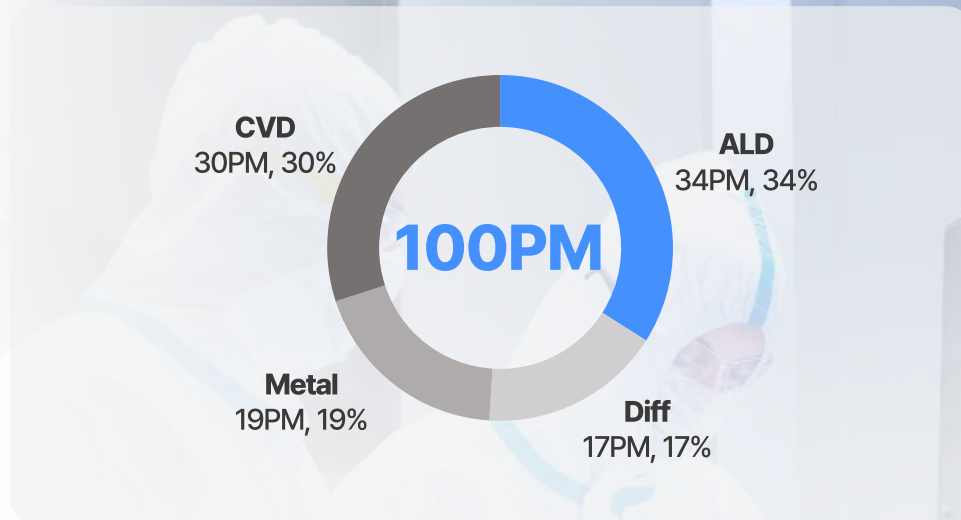
Human Resource

: R&D 인력 현황



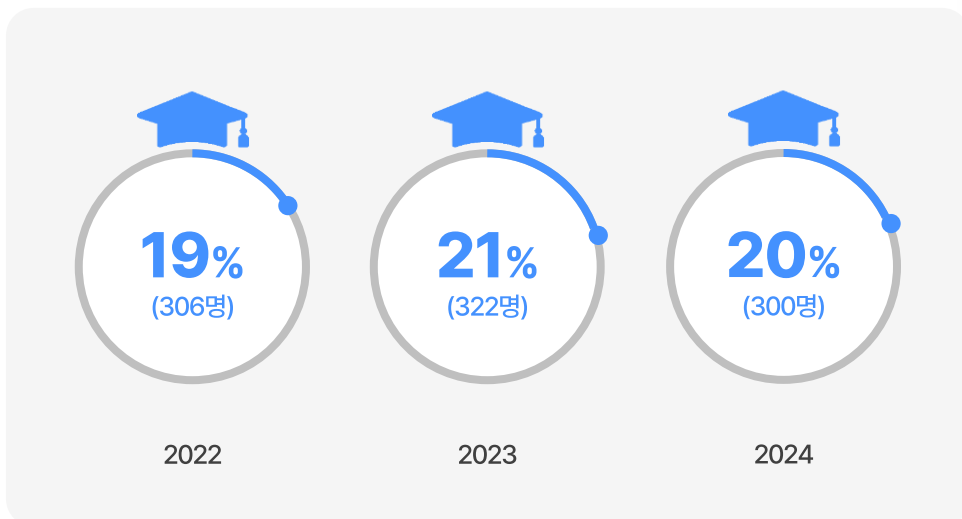
R&D 설비현황

: Semiconductor (2층 43PM, 3층 51PM, 연구2동 6PM)



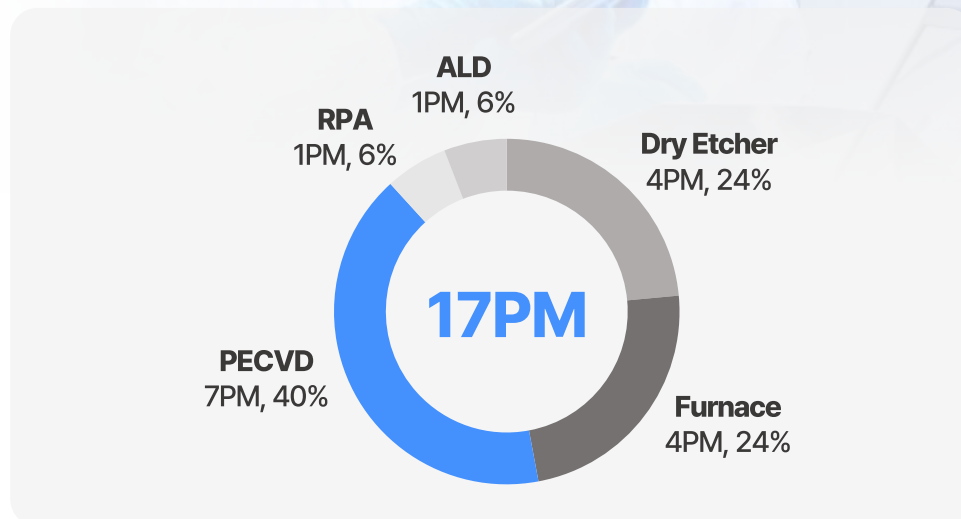
Human Resource

: 석·박사 인력 현황



R&D 설비현황

: Display (진위 11PM, 둔포 4PM, SDC 2PM)



* 2024년말 기준

특허출원 현황 (실용신안포함)



한국	중국	
1395건,	133건,	
79%	8%	
대만	미국	일본
100건,	66건,	57건,
6%	4%	3%

(단위: 건수)

	한국	중국	대만	미국	일본	합계
출원	760	64	33	30	12	899
등록	635	69	67	36	45	852
합계	1,395	133	100	66	57	1,751

사업분야별 특허출원 현황

Semiconductor (총 1,233건)



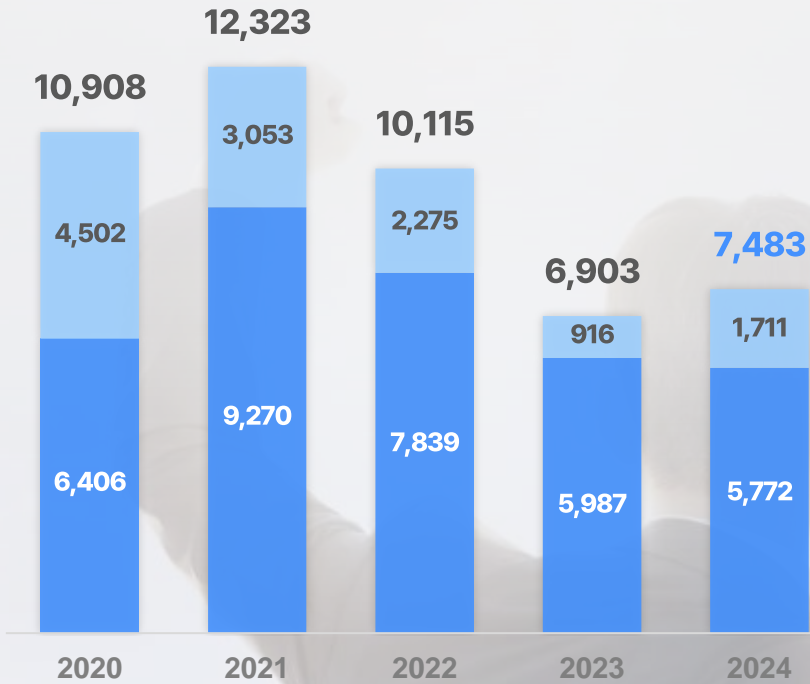
Display (총 518건)



5개년 매출현황

(단위 : 억원)

■ 반도체 ■ Display



* 별도 재무제표 기준

5개년 재무현황

(단위 : 억원)

	2020	2021	2022	2023	2024
자산 총계	11,006	11,655	11,202	10,831	11,228
유동자산	6,561	6,735	5,936	5,840	6,407
비유동자산	4,445	4,920	5,267	4,992	4,821
부채 총계	4,378	3,683	2,533	2,190	2,378
유동부채	4,311	3,611	2,503	2,104	2,302
비유동부채	68	71	30	86	76
자본 총계	6,628	7,972	8,669	8,641	8,850
자본금	245	245	245	245	245
유동비율	152%	187%	237%	278%	278%
부채비율	66%	46%	29%	25%	27%
차입금의존도	-	-	-	-	-

ESG



Environment (환경)

환경안전체제 고도화를 통한 친환경경영 확립

- 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 감축을 위한 다양한 Energy Saving 활동 실천
- 친환경 연구개발과 원천 기술 확보를 통한 제품군 다양화 및 고객사 다각화
- 환경오염물질 저감정책 적극실천을 통한 친환경 기업 구현
- 임직원의 안전과 건강증진을 위한 지속적인 안전점검 강화 및 작업환경 개선

Social (사회)

준법경영 선언 및 인권 존중을 통한 인권경영 실천

- 인도적 대우 및 차별 금지 등 인권 존중을 통한 이해관계자 중심의 경영 활동 실천
- 임직원이 행복하고 일하기 좋은 회사, 사회가 인정하는 신뢰받는 회사 구현
- 법과 원칙 그리고 합리성을 중시하는 기업문화 확립
- 지역사회와 협력사 모두 함께 동반성장을 통한 지속 가능한 성장 도모

Governance (지배구조)

공정하고 투명한 기업운영

- 독립적이고 투명한 이사회 및 감사위원회 운영을 통한 건강한 기업 문화 선도
- 주주 및 투자자 등 이해관계자의 알 권리 확보를 위한 정보공시 및 IR활동 진행
- 사업의 투명성 제고 및 건전한 기업문화 정착을 위한 제보하기 사이트 운영

동반성장

혁신역량 강화

- 협력사 품질 역량 강화를 위한 컨설팅 수행 및 교육/지원 프로그램 운영
- 품질교류회를 통한 상호 기술혁신 활동 진행

동반성장 지수평가

- 동반성장위원회의 동반성장 종합평가 참여
- 공정거래위원회의 공정거래 협약 이행평가 수행



열린 소통

- 우수 협력회사 포상 및 정기 교류회 진행
- 주요협력사 자치 협의회 (원우회) 운영
- 하도급 VOC 창구 개설

상생협력 지원

- 장비 무상임대 및 기술지원, 공동개발 등을 통한 동반성장 추구
- 월 2회 대금 지급 및 상생 결제 시스템 운영

주요 계열사

반도체	이차전지	무역	기타
원익홀딩스 원익 IPS WONIK MATERIALS WONIK QnC MOMENTIVE	WONIK PNE IIPNE POWER & ENERGY SYSTEMS TechLand	WONIK WONIK CUBE	CMS LAB WONIK L&D WONIK ROBOTICS CARELABS

매출 추이

(단위 : 억원)

